众所周知，目前全球芯片企业，主要分为三种类型，分别是设计、制造、封测。其中芯片制造是门槛最高，难度最高、资金要求也最高的领域。

目前全球也就台积电、三星
这两家工艺最先进，达到了4nm，马上就要进军3nm，可以说是遥遥领先于其它企业，这已经让全球其它国家和地区非常忌惮了。

所以当前各大国家和地区
都在发力芯片制造，比如美国、欧盟
、日本、韩国、中国大陆，都在发力芯片制造，以其将最重要的这一环拿在自己手中。

一方面是想掌握更先进的工艺技术，从而摆脱对台积电、三星的依赖，另外一方面则是提升晶圆产能，将关键的这一环抓在自己手中。

比如近日，美国就想联合日本，在2025年实现2nm，从而摆脱对台积电、三星的依赖。

那么在
这样的情况之下，从全球晶圆代工情况来看，谁的进步最大？近日，TrendForce集邦咨询发布了2022 年第一季度全球晶圆代工排名，让我们来看一看。

按照TrendForce的数据，一季度全球Top10的厂商晶圆代工产值达 319.6
亿美元（约 2147.71 亿元人民币），环比增长
8.2%，这已经是连续十一季度创下新高。

而从排名来看，这次中国大陆厂商进步非常大，已经有三家厂商进入了全球Top10，分别是中芯国际
、华虹集团、晶合集成，分别拿下了第5、6、9名，可以说是历史最好成绩。

如上图所示，中芯增长16.6%，市场份额为5.6%，排名全球第五；而华虹增长20.8%，份额为3.2%，排名全球第六；晶合集成增长26%，份额为1.4%，排名全球第六名。

而上一季度晶合集成还排名全球第10名，这次一举超越高塔半导体（Tower）至第9名。

而从数据来看，三星负增长，台积电增长了11.3%，但中国大陆的三大厂商，则是Top10厂商中，增长率最高的，特别是华虹、晶合集成，增长率超过了20%，说明这一季，我们确实是增长全球最快，这也意味着中国芯在高速发展，你觉得呢？